SUBSTRATE PROCESSOR

Patent number:

JP10308430

Publication date:

1998-11-17

Inventor:

MIZOHATA YASUHIRO; WATANABE JUN; KOYAMA

YOSHIHIRO

Applicant:

DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

Classification:

- international:

H01L21/68; B08B3/08; B08B3/12; H01L21/304

- european:

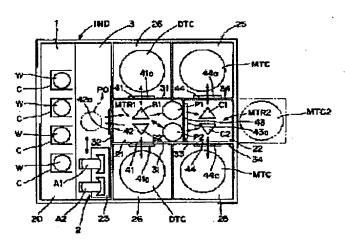
Application number: JP19970328684 19971128

Priority number(s):

Abstract of JP10308430

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a substrate processor in which it is possible to easily facilitate a countermeasure to chemicals, and to process a substrate with high quality.

SOLUTION: Wafers are successively processed by a chemicals processing part MTC and a washing and drying processing part DTC, and a clean wafer can be obtained. The carriage of the wafer from an indexer part IND to each processing part MTC and DTC is operated by first and second carrying robots MTR1 and MTR2 constituted of articulated robots. The first and second carrying robots MTR1 and MTR2 can perform access to each processing part MTC and DTC and wafer placing plates P1 and P2 by the bending of the articulates, and seal for a countermeasure to chemicals can be easily attained. Also, the first and second carrying robots MTR1 and MTR2 are provided with two arms each, that is, wafer carrying-in arms B1 and C1 and wafer carrying-out arms B2 and C2. Therefore, the wafers can be held by the different arms at the time of pre-processing and post-processing at each processing part MTC and DTC.



Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-308430

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

(51) Int.CL ⁶	織別包号	P l
HOIL 21/68		HO1L 21/68 A
B08B 3/08		B 0 8 B 3/08 Z
3/12		3/12 A
H01L 21/304	3 4 1	HOIL 21/304 341C
		審査請求 京請求 商求項の数9 OL (全 16 円)
(21)出顯番号	坊顧平9−328684	(71) 出庭人 000207551
		大日本スクリーン製造株式会社
(22)出版日	平成9年(1997)11月28日	京都府京都市上京区坂川通寺之内上る4丁
	•	目天神北町1番地の1
(31)優先権主張番号	特圈平9-50765	(72)発明者 磷畑 保廣
(32)優先日	平9 (1997) 3月5日	京都府京都市伏見区羽束師古川町322番地
(33)優先権主張国	日本 (J P)	大日本スクリーン製造株式会社格画事業
		所內
		(72) 発明者 渡辺 純
	•	京都的京都市伏見区羽東師古川町322番地
		大日本スクリーン製造株式会社落西筆業
		所内
		(74)代理人 弁理士 稀閏 耕作 (外1名)
		最終質に続く
_		

(54) 【発明の名称】 基板処理装置

(57)【要約】

【課題】 楽液対策が容易で、基板を高品質に処理できる 基板処理装置を提供する。

【解決手段】薬液処理部MTCおよび水洗・乾燥処理部DTCによって、順にウエハが処理され、結浄なウエハが得られる。インデクザ部INDから各処理部MTC,DTCへのウエハの銀送は、多関節ロボットからなる第1および第2根送ロボットMTR1、MTR2によって行われる。第1および第2根送ロボットMTR1、MTR2は、関節の屈伸により、処理部およびウエハ鉄世P1、P2にアクセスすることができるものであり、高が策のためのシールが容易である。また、第1および第2根送ロボットMTR1、MTR2は、それぞれ2本のアーム、すなわちウエハ根入アームB1、C1およびウエハ鉄出アームB2、C2を有している。したがって、各処理部での処理前と処理後とで、異なるアームでウエハを保持できる。

